

2024 法人說明會

總經理 黃道景 2024.6.27

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

投資安全聲明



本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。

公司簡介

創立：1993年

資本額：4.4億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

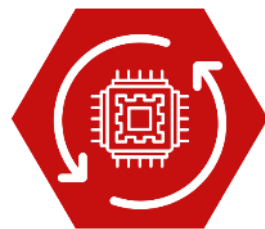


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備



自有研發與製造

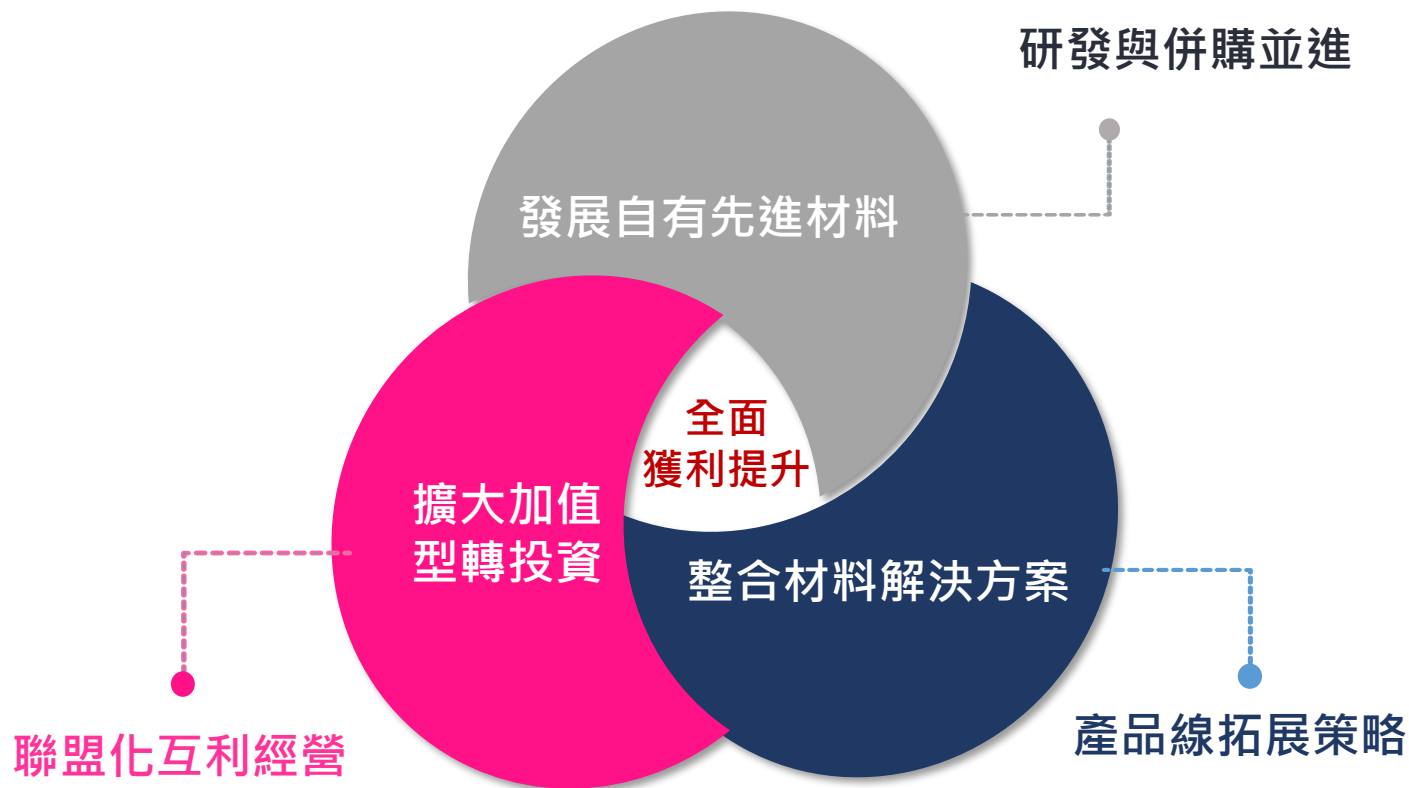
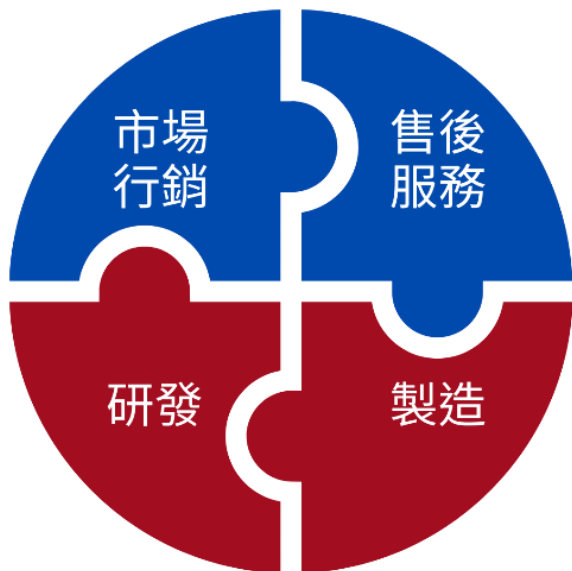
1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿



營運展望

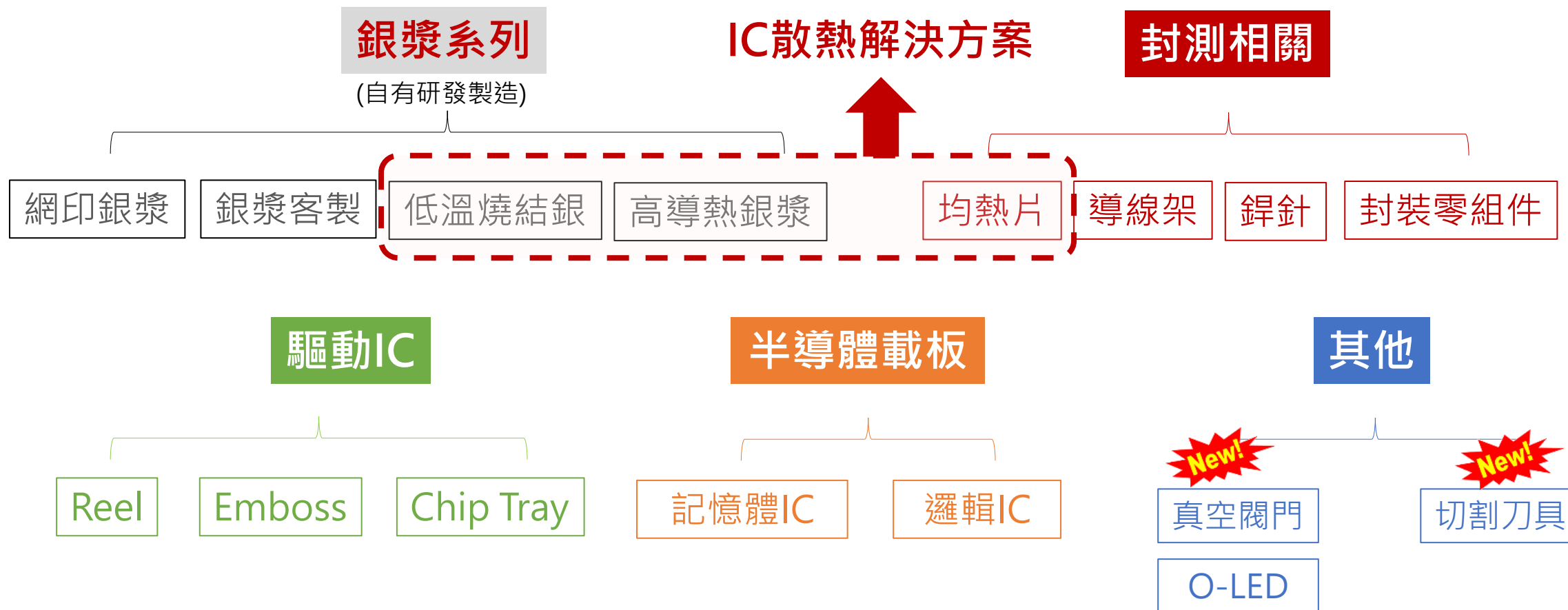
代理商 ➔ 整合型材料供應商

轉型全面提升獲利



布局一：整合材料解決方案

整體解決方案 一站購足



布局一：整合材料解決方案

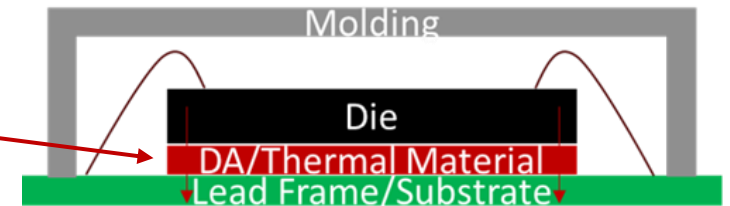
IC散熱解決方案



發展自有先進材料

1. Die Attach (導熱銀漿、燒結銀漿)-將Die所產生的熱導到Die之外

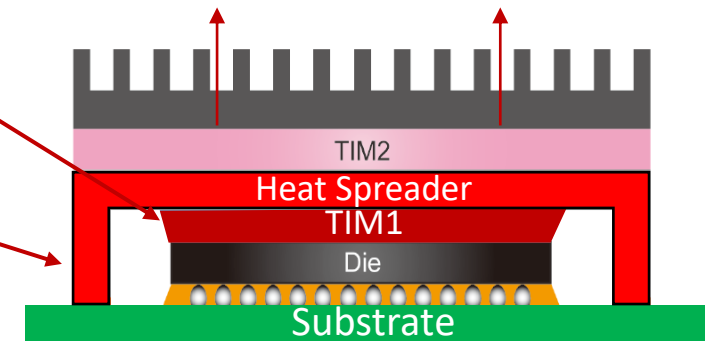
- 封裝方式: Wire Bond Package
- 終端應用: 第三代半導體封裝製程、車用、IGBT、快充



2. TIM1 (燒結銀漿)-位於Die與Heat Sink的熱介面材料， 排開空氣有效建立熱傳導通道

3. Heatsink-晶片在封裝的過程把熱導到package外面

- 封裝方式: Flip Chip Package
- 終端應用: AI、伺服器、基地台

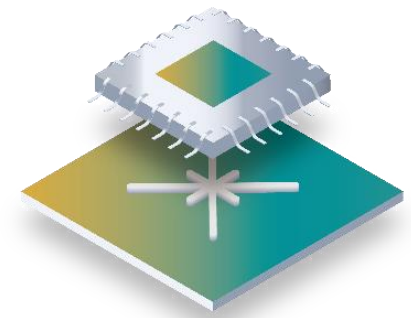
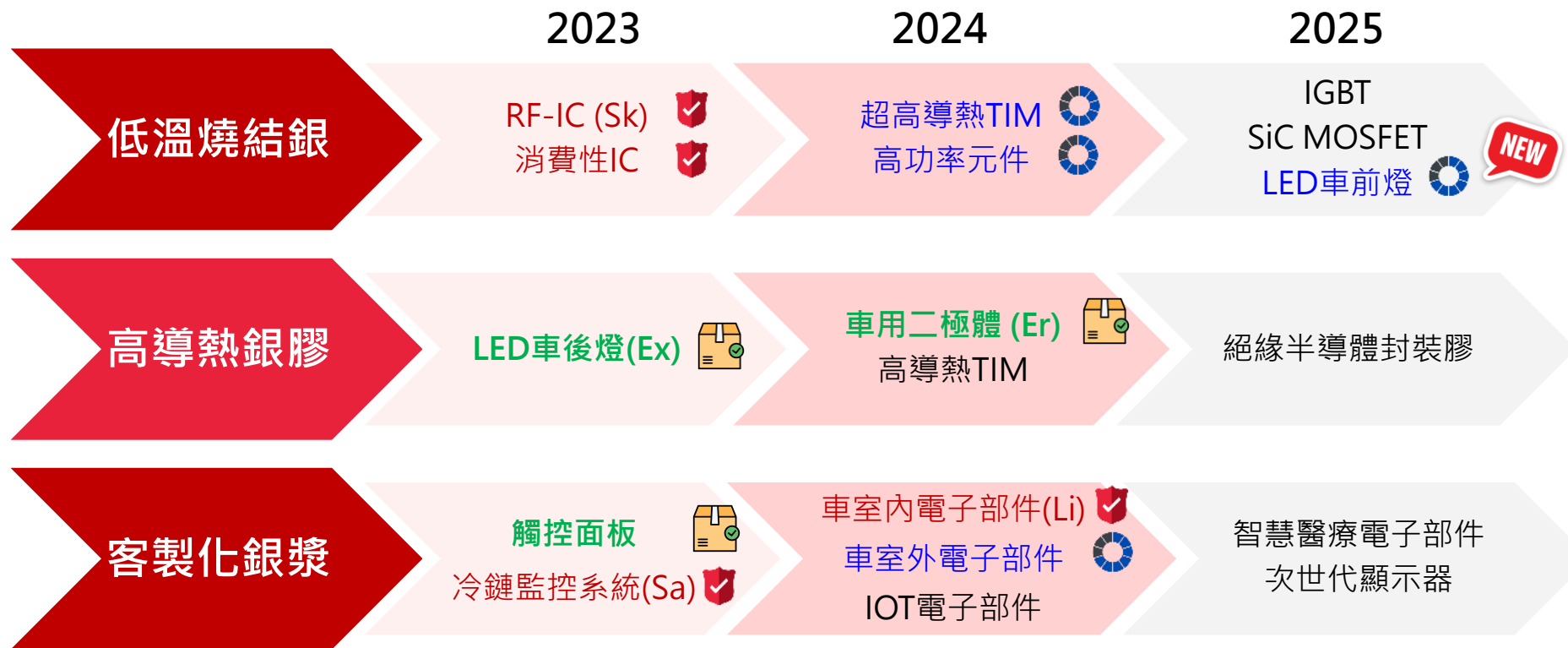


布局二：發展自有先進材料

1 自有研發

銀漿產品依發展藍圖推展順利

-  驗證通過
-  驗證進行中
-  量產



布局二：發展自有先進材料

1 自有研發 2024聚焦高功率元件、高運算散熱應用

- 客製化銀漿
- 低溫燒結銀
- 高導熱銀膠

高功率元件

車用電子

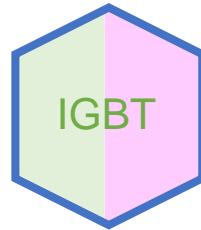


- 1. 高附著強度
- 2. 高信賴性

高功率
LED

- 1. 超高散熱性
($> 200 \text{ W/mk}$)
- 2. 高信賴性

高功率元件



- 1. 適用大尺寸
($> 5 \times 5 \text{ mm}$)晶片
- 2. 高散熱性
($> 150 \text{ W/mk}$)

高運算散熱

AI



- 1. 高導熱性
- 2. 高韌性
- 3. 高信賴性

IOT



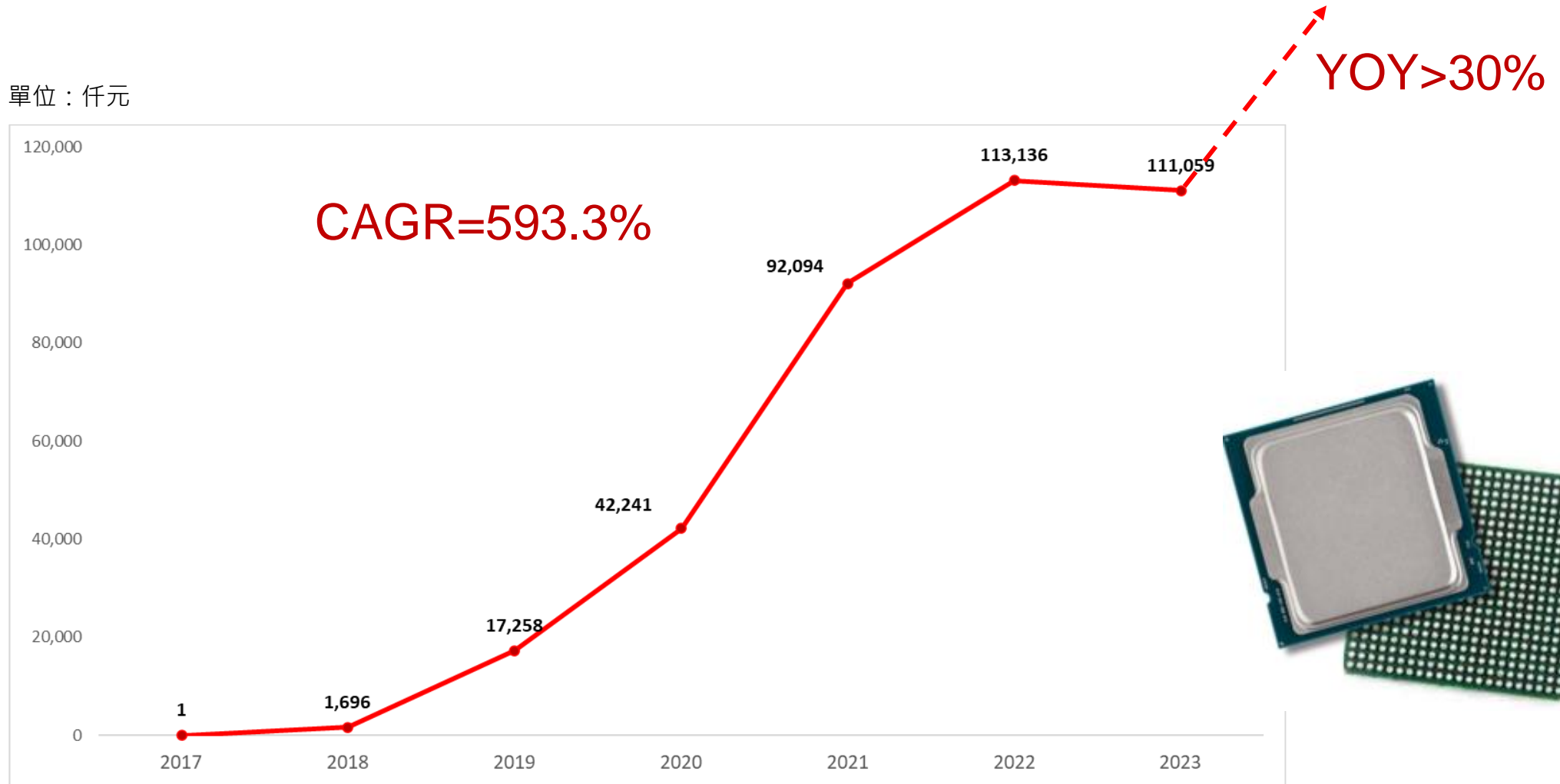
- 1. 快速固化
- 2. 高導電性

2 併購Heat Sink均熱片廠商

1. 建置Heat Sink電鍍不同製程，包括電解電鍍鎳&化學電鍍鎳，可承接所有封裝客戶需求，服務更全面性。
2. 成為客戶Heat Sink 之安全、及時供貨、高品質高技術的主要供應商之一。
3. 2024持續推動均熱片廠商併購案。

均熱片歷年營收

單位：仟元



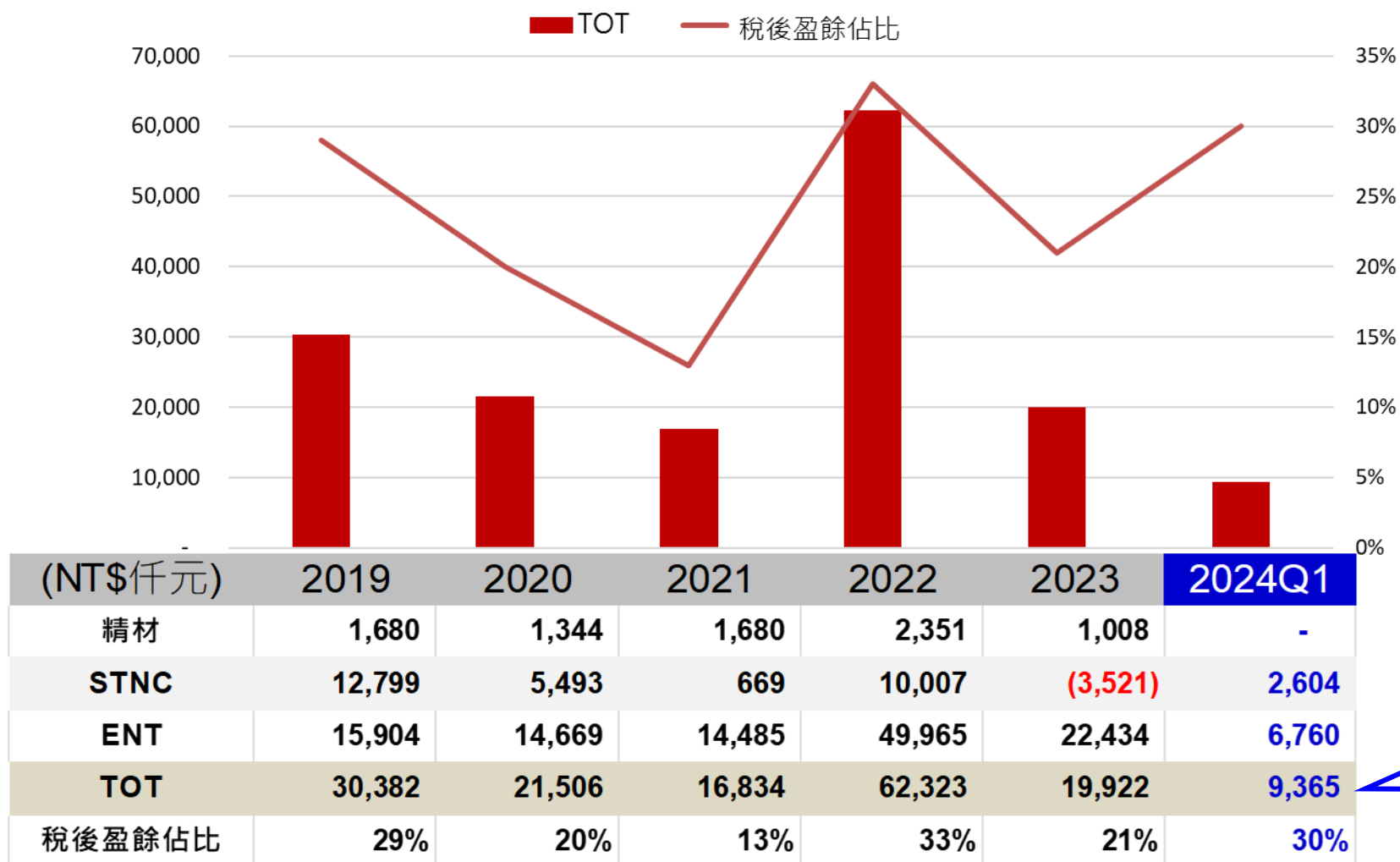
布局三：擴大加值型轉投資



聯盟化經營 互惠互惠

1. Simmtech 蘇州(STNS)已由成本中心轉為利潤中心，佣金率提高，Q1實質貢獻投資收益260萬，季增461%。同時利機3月底持股由30%提升至49%，預期可挹注2024年投資收益大幅成長。
2. 利機與日本Enplas集團藉由擴大利騰台灣持股，共同經營大陸高階Socket市場。
3. 利機與勤輝科技共投資精材科技，擴大Emboss、Reel等驅動IC材料市場，去年獲利良好，提高利機股利收入。

現有三大加值型轉投資長期穩定貢獻獲利



已達去年47%



營運報告

綜合損益表



1Q 2024

(NT\$仟元)	2020	2021	2022	2023	1Q 2024	QoQ	YoY
營業收入	964,457	1,218,919	1,060,398	976,397	238,074	-3%	13%
營業毛利	269,474	310,457	310,949	255,756	63,037	-1%	11%
毛利率	28%	26%	29%	26%	26%	-	-2%
營業淨利	118,685	150,568	124,057	75,279	13,241	-43%	57%
營業外收(支)	6,510	15,294	110,067	36,565	23,801	225%	75%
稅前淨利	125,195	165,862	234,124	111,844	37,042	830%	68%
本期淨利	106,431	134,428	195,976	93,545	31,079	1087%	46%
淨利率	11%	11%	18%	10%	13%		
EPS (NT\$)	2.72	3.44	5.01	2.16	0.70	1300%	35%

資產負債表



NT\$仟元	2020	2021	2022	2023	1Q 2024
資產					
現金及約當現金	170,088	279,765	327,431	398,797	263,564
應收帳款	597,702	509,553	532,247	443,432	475,723
存貨	47,736	66,764	60,048	67,008	60,584
轉投資相關	188,357	205,830	257,247	263,434	294,880
不動產、廠房及設備	227,025	228,528	226,154	223,341	282,946
其他資產	71,074	23,817	26,539	34,288	31,731
資產總計	1,301,982	1,314,257	1,429,666	1,430,300	1,409,428
負債					
短期借款	224,782	126,429	150,000	-	-
應付帳款	240,718	265,051	227,968	233,559	207,300
其他負債	99,569	115,613	131,435	110,272	198,495
負債總計	565,069	507,093	509,403	343,831	405,795
權益總計	736,913	807,164	920,263	1,086,469	1,003,633
淨值 (NT\$元)	18.84	20.64	23.53	24.63	22.75

歷年營收/接單金額

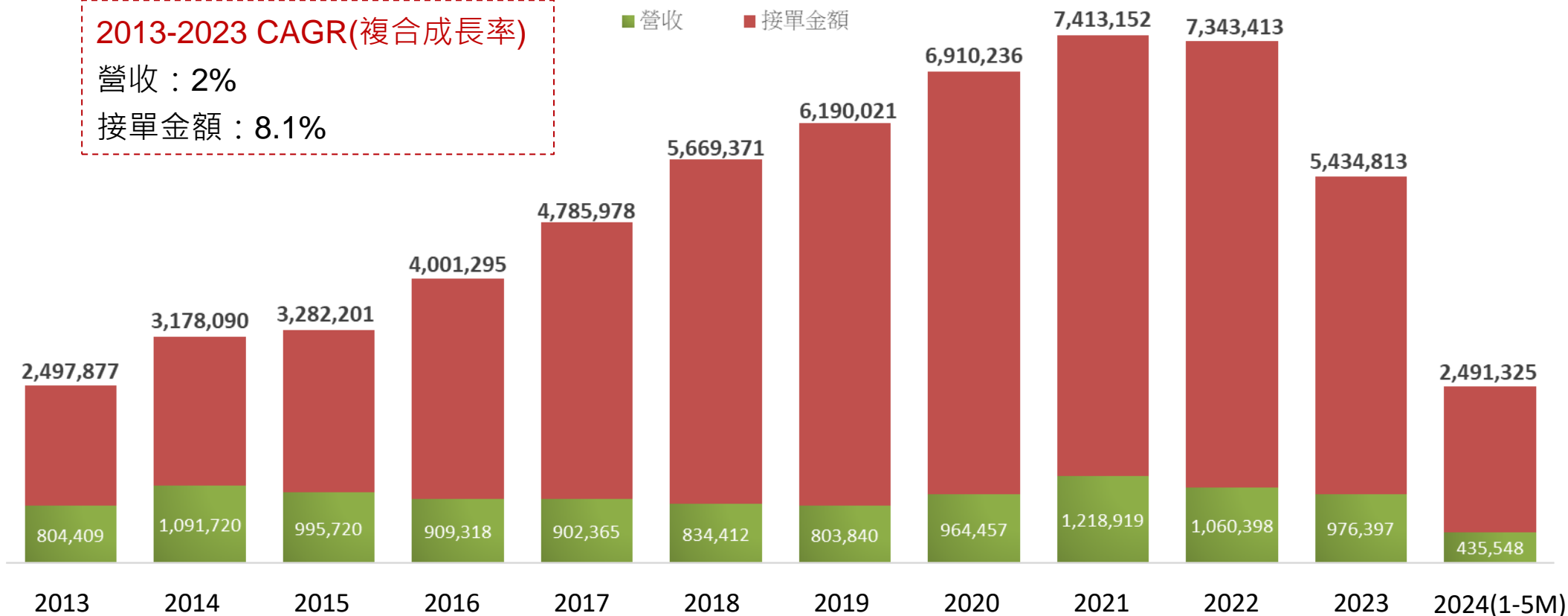


單位：仟元

2013-2023 CAGR(複合成長率)

營收：2%

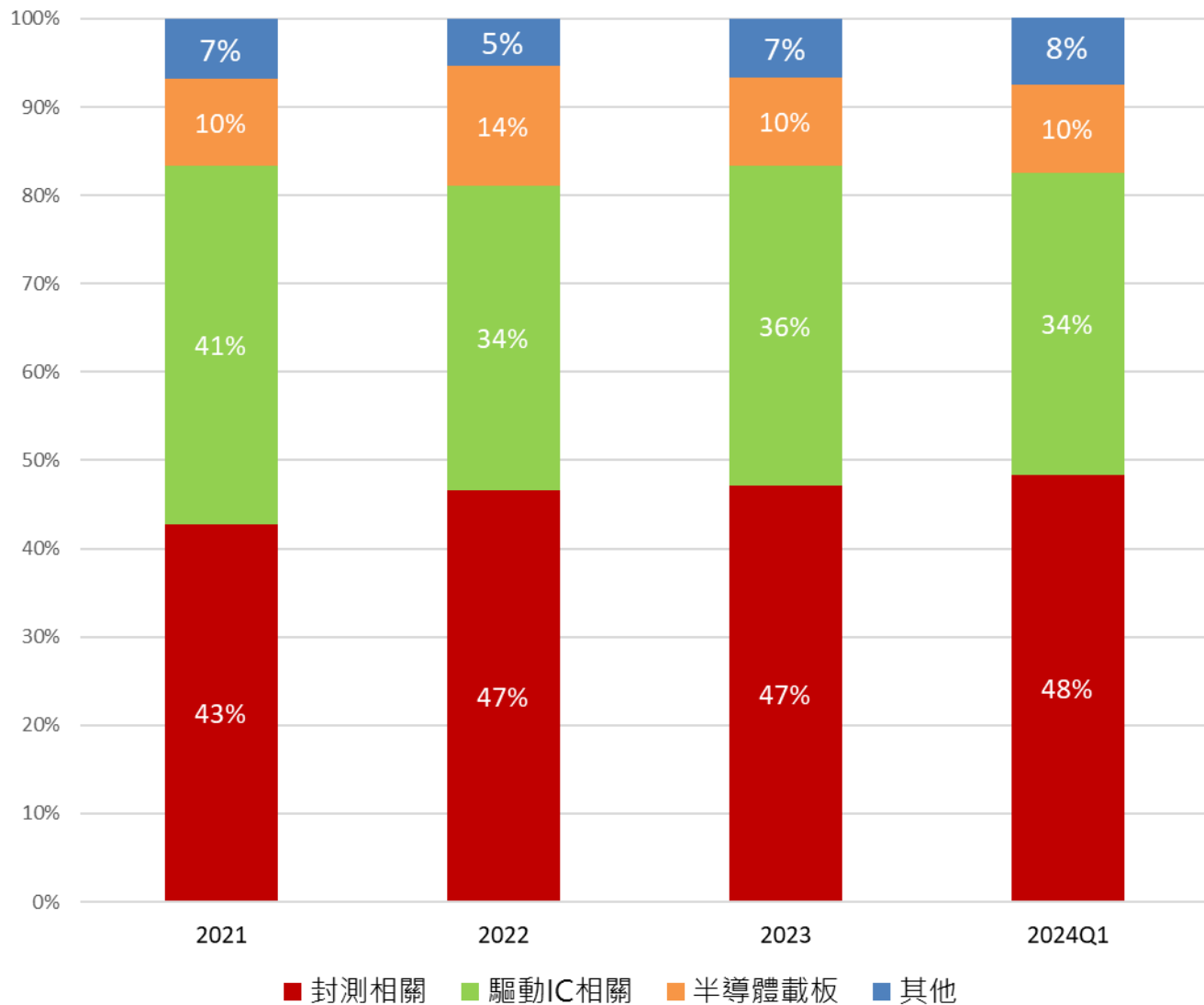
接單金額：8.1%



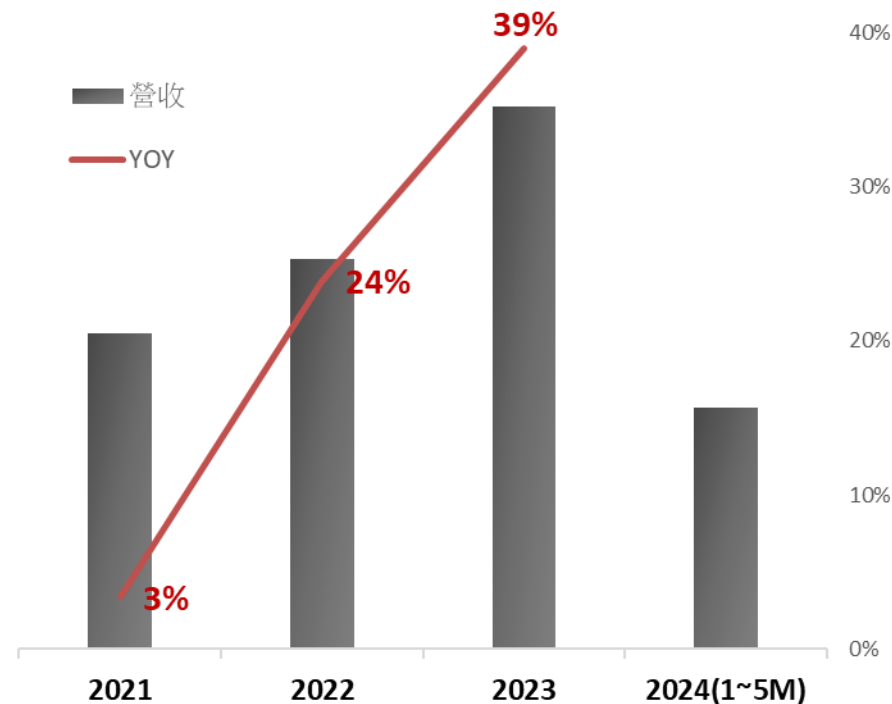
說明： 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

產品別營收佔比



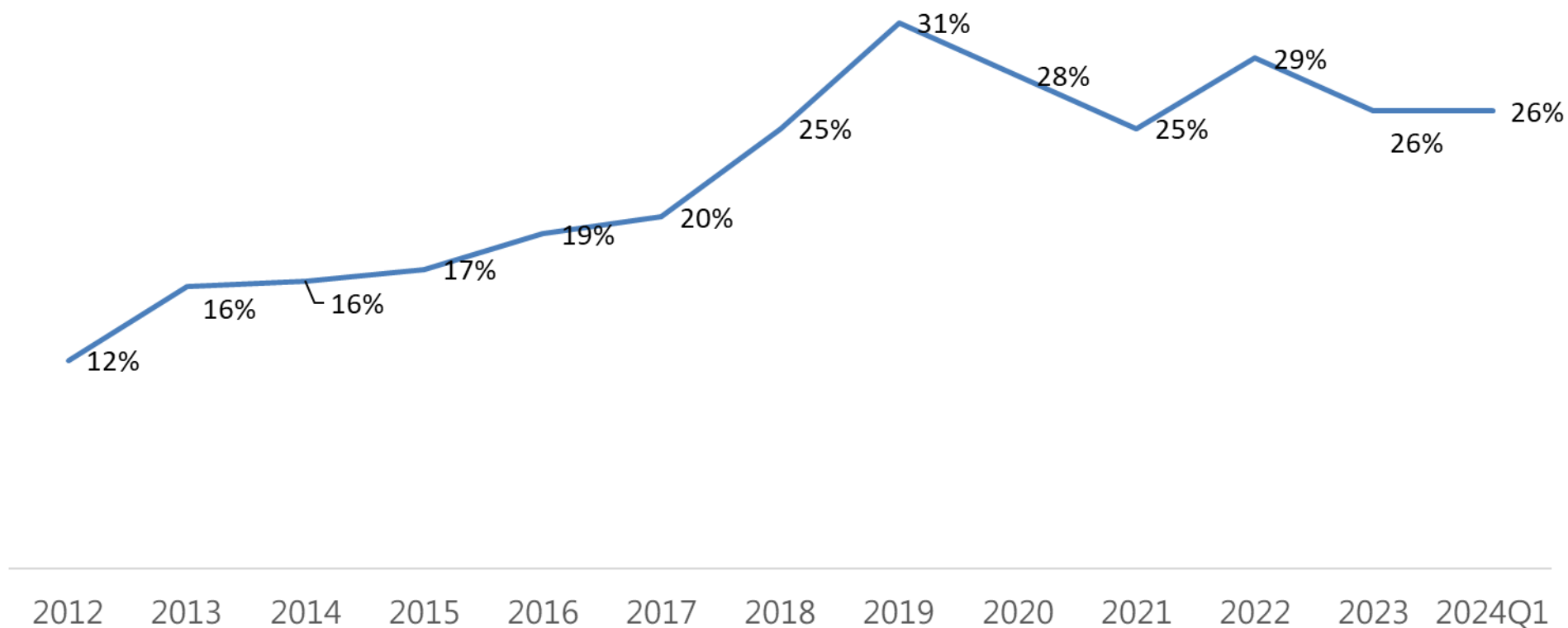
銀漿營收成長



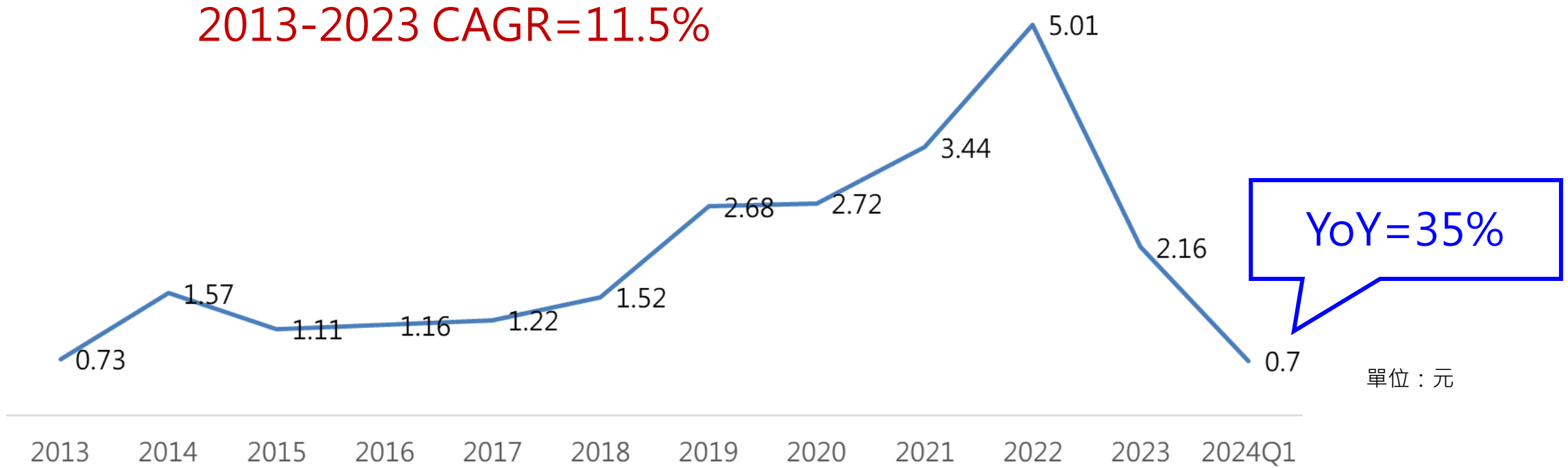
歷年毛利率



2012-2023 CAGR=7.4%



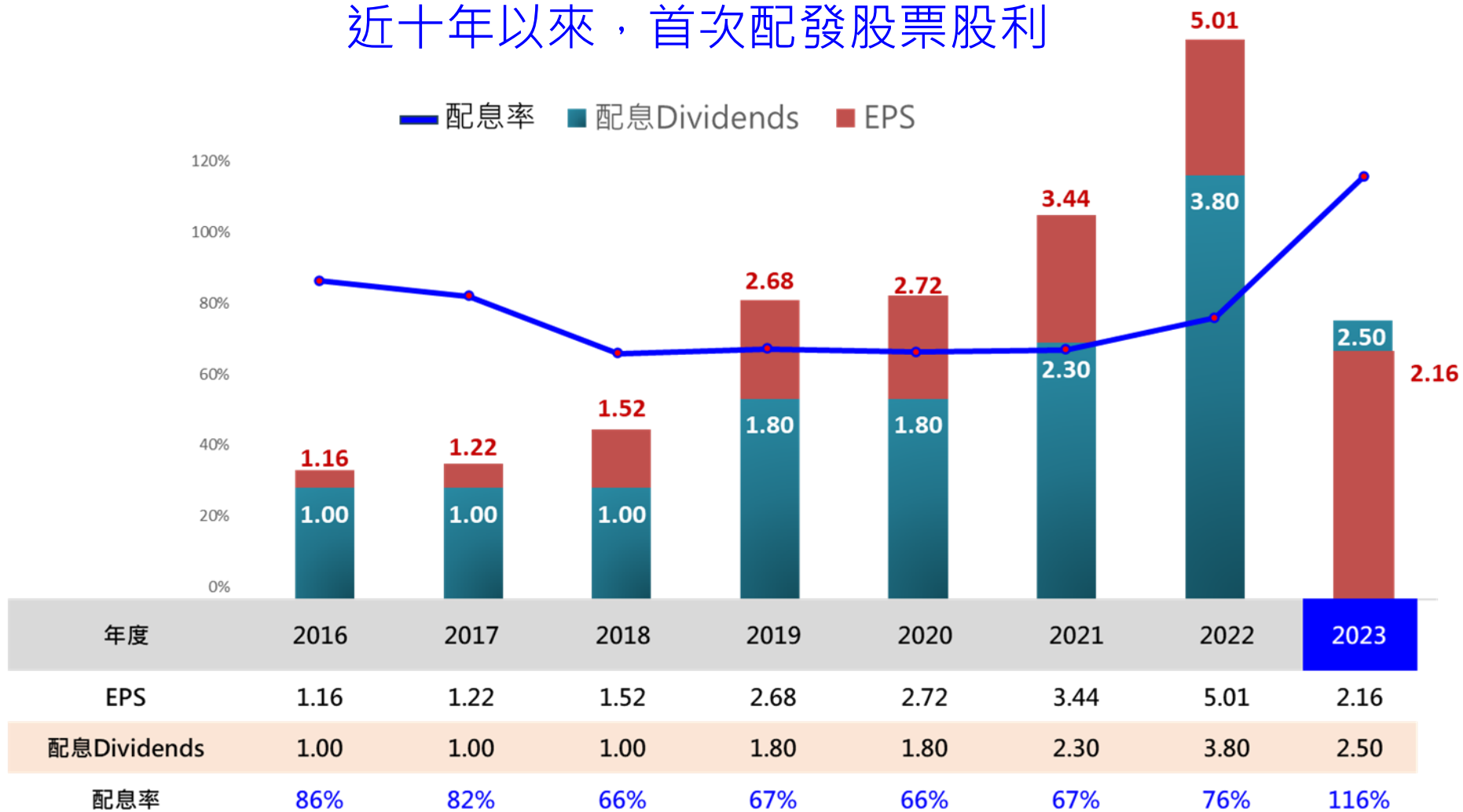
歷年每股稅後盈餘



歷年配息率

股東會通過配發每股2.3元現金及0.2元股票股利，配息率達116%

近十年以來，首次配發股票股利



- 一. 2024 Q1 營業毛利年成長11%，表現優於預期。驅動IC、封裝相關、半導體載板等三大產品族群業績逐季成長，全年營運樂觀看待。
- 二. 銀漿產品-部分量產並有多家廠商驗證中。聚焦高功率元件、高運算散熱，高功率元件下半年有望獲新訂單。
- 三. 新產品-營運成長新動能
 - 1) 閥類-上半年獲新訂單，下半年新產品上市，並有多家客戶驗證中。
 - 2) 切割刀-package saw有望取得與封裝大廠合作機會。
- 四. 加值型轉投資-STNS轉換為利潤中心，Q1已轉虧為盈，2024年獲利貢獻有望大幅成長。



THANK YOU

